

CCI & MEC

Ваши партнеры по подготовке
поверхности



Virginie HENRIOT
24-26 марта 2015
Москва, Россия

ОБЗОР

- ◎ Растворы для снятия фоторезиста и защитной паяльной маски
 - RISTOFF C-8
 - RISTOFF C-53
 - RISTOFF C-71
- ◎ Коричневый оксид
 - MEC V-BOND BO7710 V
- ◎ Флюс
 - MEC HASL FLUX W-2365 XP
- ◎ Раствор для снятия металлорезиста
 - MEC REMOVER S-1728
 - MEC REMOVER NH-1866

Фоторезист / Защитная паяльная маска

- ◎ RISTOFF C-8 : Снятие защитной маски
- ◎ RISTOFF C-53: Снятие фоторезиста
- ◎ RISTOFF C-71: Снятие фоторезиста (базовый состав Моноэтаноламин)

RISTOFF C-8

Процесс, экономия производителей
PCB в Европе составляет несколько
тысяч € в год

Раствор для снятия защитной паяльной маски RISTOFF C-8

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- Защитная паяльная маска

ОСОБЕННОСТИ:

- Полностью удаляет защитную маску
- Без остатков
- Базовый состав 100% щелочь
- Не влияет на основание ламината

Раствор для снятия защитной паяльной маски RISTOFF C-8

РАБОЧИЙ РАСТВОР:

Концентрация (1:1)

⇒ Развести 50% концентрата дистиллированной водой

ПРОЦЕСС:

- ⦿ Температура 55-60°C
- ⦿ Время процесса < 45 мин до 2 час

Раствор для снятия защитной паяльной маски RISTOFF C-8

Ristoff®

Creative Chemistry In Action

- Sun Chemical-Imagagecure® range
- Taiyo-PSR Series
- Probimer® 77
- Lakwerke Peters Elpemer® range
- Electra-Carapace®
- Tamura-DSR Series
- Elga-OPSR 560

Все успешно обработаны с помощью C-8

RISTOFF C-53

В настоящее время заменяет все растворы для снятия сухого пленочного фоторезиста

Раствор для снятия фоторезиста RISTOFF C-53

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- Сухой пленочный фоторезист

ОСОБЕННОСТИ:

- Базовый состав ТМАН и моноэтаноламин
- Без растворителей и каустической соды
- Эксклюзивный, уникальный антикоррозийный раствор -
> Меньше помех при измерении OAI и оставляет лужение в исходном состоянии
- Устраняет проблемы замедленного травления, вызванного путем осаждения сплавов металла, особенно на медной поверхности толщиной (5,9,12 мкм)
- Может использоваться для всех сухих фоторезистов :
 - Наружные-внутренние слои (кислое и щелочное травление)
 - Покрытие никель/золото

RISTOFF C-71

Заменит все используемые в настоящее время растворы для снятия фоторезиста

РАСТВОР ДЛЯ СНЯТИЯ ФОТОРЕЗИСТА RISTOFF C-71

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- Сухой пленочный фоторезист

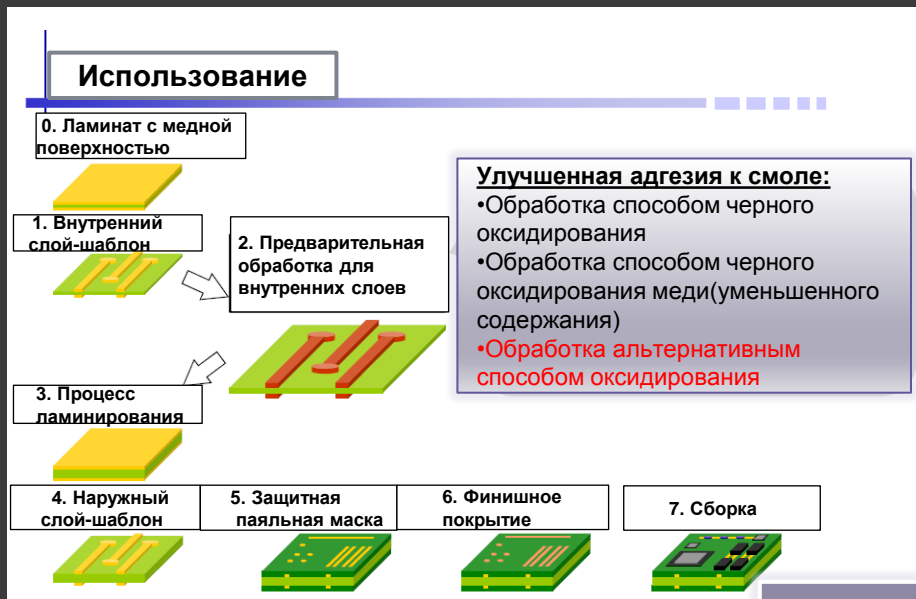
ОСОБЕННОСТИ:

- Экономичный раствор для фоторезиста
- Базовый состав Моноэтаноламин
- Без Каустика, Растворителя и ТМАН
- Используется для наружных слоев и кислого травления (Не используется для Nickel/Gold или щелочного травления)

MEC V-BOND BO7710 V

**Brown oxide Экономичный
раствор**

КОРИЧНЕВЫЙ ОКСИД MЕС V-BOND VO7710 V



VO-7710 V это альтернативный способ обработки черного оксидирования меди(& уменьшенный)

H₂SO₄-H₂O₂ это способ химического микроотравления

Этот химический раствор может создавать уникальную поверхность топографии и великолепную адгезию на пленке с органической медью



Медная органическая пленка
(эффект грунтовки)

+

Микрорельеф
Анкерный эффект

Отличная
адгезия

Коричневый оксид

МЕС V-BOND VO7710 V

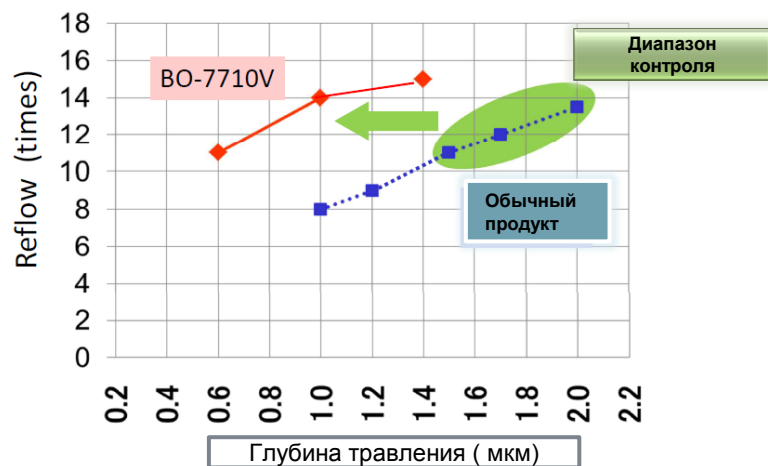
ОСОБЕННОСТИ:

- Низкий объем травления
- Нет предварительного процесса погружения
- Автоматический анализатор
- Простота обслуживания

Сохраняя эффективную производительность VO 7710, экономит эксплуатационные расходы, расходы на техническое обслуживание и т.д.

Коричневый оксид MЕС V-BOND VO7710 V

1. Низкая глубина травления



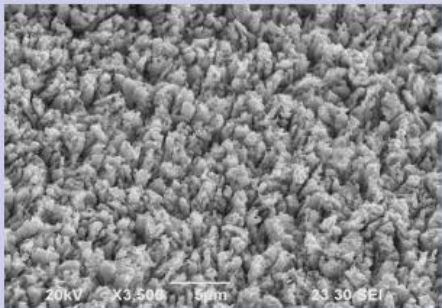
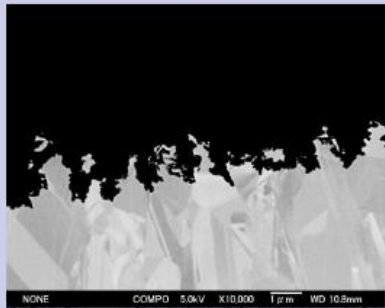
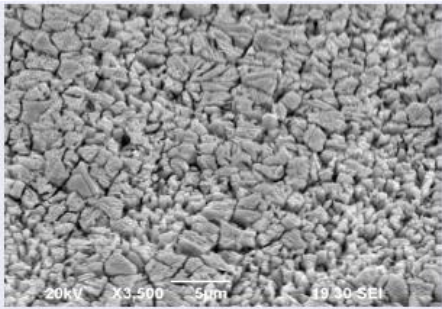
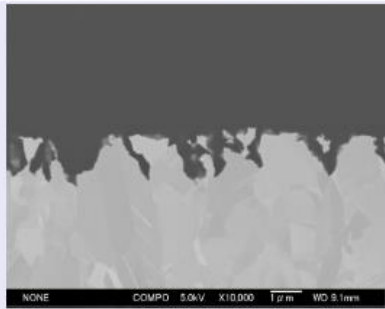
Почему?

	Обычный продукт 2.0um	VO-7710V 1.0um
Поперечный разрез X10,000		
Ra	0.38	0.33
Rz	4.01	4.13

Шероховатая поверхность состава раствора VO-7710V с глубиной травления 1 мкм соответствует глубине травления 2 мкм обычного раствора

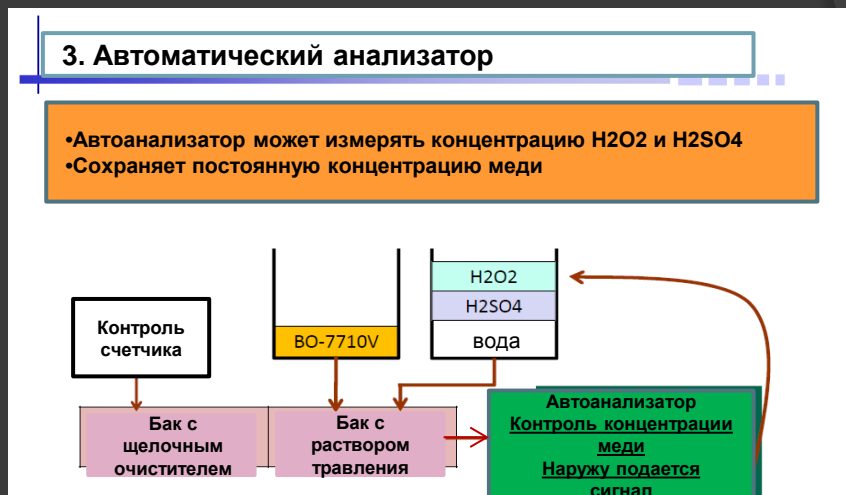
Коричневый оксид MЕС V-BOND BO7710 V

ТОПОГРАФИЯ:

	Surface structure (x3,500)	Cross section (x10,000)
Conventional Product 2.0um		
BO-7710V 1.0um		

BROWN OXIDE MEC V-BOND BO7710 V

ПРОЦЕСС:



MEC HASL FLUX W-2365 XP

экономичная цена

FLUXES

MEC HASL FLUX W-2365 XP

Использование:

- Флюс для горячего лужения

Особенности:

- Хорошая совместимость
- Не содержит свинца
- Выдерживает струю воды
- Высокий уровень паяльной способности поверхности
- Остатки после пайки полностью растворимы в воде и легко удаляются путем промывки водой
- Очень низкая задымляемость, очень низкие карбоновые остатки
- Защищает от брызг попадания на припой.
- Нет проблем от шариков и перемычек припоя

Удаление металлорезиста

- ◎ MEC REMOVER S-1728: снятие Sn/Pb
- ◎ MEC REMOVER NH-1866: снятие Ni

MEC REMOVER S-1728

**Пошаговый и готовый к
использованию**

**Без фтора, без перекиси водорода
раствор для снятия Sn/Pb**

METAL STRIPPER MEC REMOVER S-1728

Использование:

- Снятие Sn/Pb

Особенности:

- Пошаговый и готовый к использованию
- Без фтора, без перекиси водорода и на основе азотной кислоты
- Нет опасности для пятен.
- Быстрая скорость снятия (10-15 мкм/мин)
- Очень низкое действие на поверхность меди
- Легкая утилизация
- Производительность : до 190 г/л для Sn(Pb) при постоянной скорости.

MEC REMOVER NH-1866

Раствор для снятия Nickel

Раствор для снятия никеля MCS REMOVER NH-1866

Использование:

- ⦿ Травление Ni или сплава Ni/Cu

Особенности:

- ⦿ Химический и Электролитический Nickel
- ⦿ Низкая скорость травления Ni (менее 0.4 мкм/мин)

METAL STRIPPER MEC REMOVER NH-1866

Рабочий раствор:

- Дистиллированная вода 60%
- 62.5% HNO_3 30%
- NH-1866 10%

Добавить 70г/л 35% H_2O_2 в раствор смеси

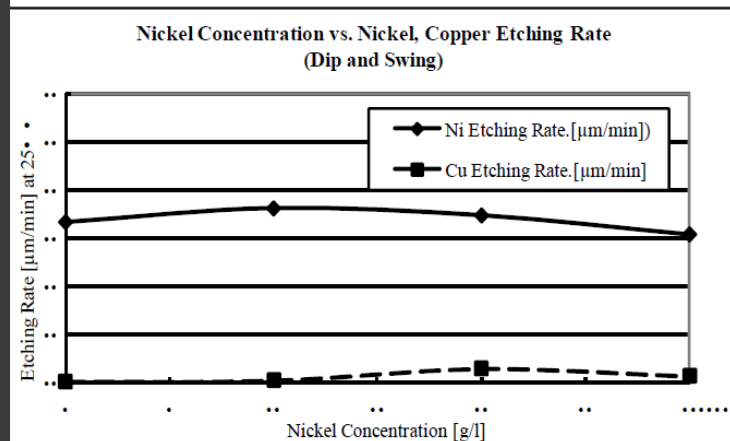
Контроль растворов в баках:

- Концентрация кислоты
- Концентрация никеля
- Концентрация перекиси водорода
- Скорость травления меди

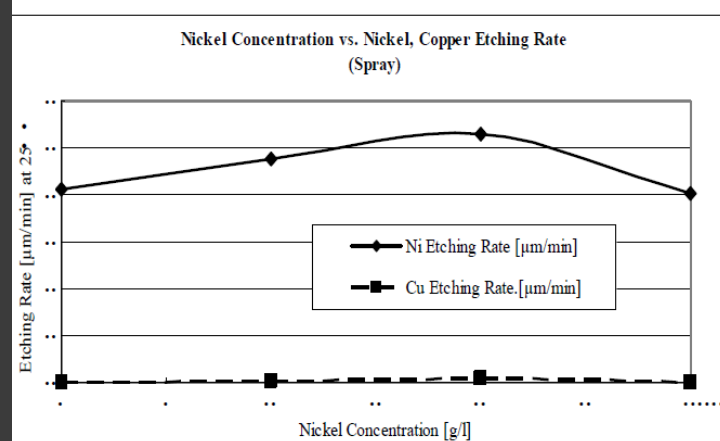
METAL STRIPPER MEC REMOVER NH-1866

Характеристики:

Etching Rate (Dipping)



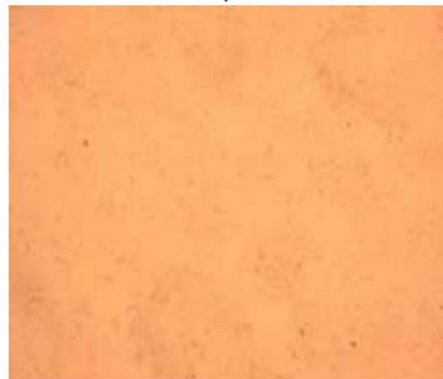
Etching Rate (Spraying)



Etched by Former Product



Etched by NH-1866



**Меньше
осталось
никеля на
поверхности
меди**

ССІ & МЕС ВАШИ ПАРТНЕРЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ПОВЕРХНОСТИ

В ваших руках есть все возможности сделать
правильный технической и разумный выбор!!!

**СПАСИБО ЗА ВАШЕ
ВНИМАНИЕ!!!**

Есть ли у Вас вопросы?